

关于上海伟测半导体股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券申请文件
的问询函中有关财务事项的说明

目 录

一、关于本次募投项目·····	第 1—15 页
二、关于业务与经营情况·····	第 15—33 页

关于上海伟测半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的问询 函中有关财务事项的说明

天健函〔2026〕6-113 号

上海证券交易所:

由平安证券股份有限公司转来的《关于上海伟测半导体股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2026〕200号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的上海伟测半导体股份有限公司（以下简称伟测科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。

除另有标注外，本说明的金额单位为万元。本说明中若明细项目金额加计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。2026年6月30日/2026年1-6月数据未经审计。

一、关于本次募投项目

根据申报材料：（1）本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过200,000.00万元（含本数），用于伟测科技上海总部基地项目、伟测科技西南总部及研发测试基地项目以及偿还银行贷款及补充流动资金；报告期内，公司产能利用率分别为63.27%、76.79%、74.19%和72.49%；（2）伟测科技西南总部及研发测试基地项目尚未取得土地使用权证，前次募投项目“高端芯片测试”包含AI算力芯片。

请发行人说明：（5）本次募投项目各项投资构成情况、测算过程及测算依据，相关测算与公司前次募投项目及同行业公司可比项目的对比情况，是否存在重大差异；（6）本次募投项目效益测算中测试单价、时长等指标选取的主要依

据，与公司现有产品及可比公司同类产品是否存在重大差异，新增折旧摊销对公司未来业绩的影响，本次效益测算是否谨慎、合理；（7）结合公司货币资金余额、资产负债结构等，说明本次融资的必要性、融资规模的合理性。

请申报会计师核查问题（5）-（7）并发表明确意见。（审核问询函问题 1 之(5)至(7)）

（一）本次募投项目各项投资构成情况、测算过程及测算依据，相关测算与公司前次募投项目及同行业公司可比项目的对比情况，是否存在重大差异

1. 本次募投项目各项投资构成情况、测算过程及测算依据

本次募投项目总体投资情况列示如下：

序 号	名称	投资总额	本次募集资金拟投入金额
1	伟测科技上海总部基地项目	98,740.00	70,000.00
2	伟测科技西南总部及研发测试基地项目	100,000.00	80,000.00
3	偿还银行贷款及补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合 计		248,740.00	200,000.00

各项目的具体投资构成及明细，各项投资构成的测算过程和测算依据列示如下：

（1）伟测科技上海总部基地项目（上海项目）

上海项目的投资总额为 98,740.00 万元。具体情况如下表所示：

序 号	项目	投资金额	使用本次募集资金金额	募集资金金额占比
1)	建设投资	97,740.00	70,000.00	100.00
①	土地及基础设施建设费用	44,370.95	25,800.00	36.86
②	设备购置费	52,394.62	44,200.00	63.14
③	预备费	974.43		
2)	铺底流动资金	1,000.00		
合 计		98,740.00	70,000.00	100.00

1) 土地及基础设施建设费用

土地及基础设施建设包括相关土地使用权的出让金、厂房土建和机电工程等，具体投资构成、测算过程及测算依据如下：

序 号	项目	投资金额	测算依据
-----	----	------	------

序 号	项目	投资金额	测算依据
1	土地	4,431.00	工业用地，已签订土地使用权出让合同，按合同实际金额
2	厂房土建	20,200.00	已签订合同，按合同实际金额
3	机电工程	16,320.00	已签订合同，按合同实际金额
4	装修	1,799.95	参考公司已实施无锡、南京同类项目装修标准
5	变电站	1,620.00	依据项目用电负荷需求，参考区域工业配套变电站市场造价水平测算
合 计		44,370.95	

截至本回复出具日，本项目上海项目主体工程已封顶，项目实际发生工程量与前期投资测算的建设规模基本匹配，未出现重大差异。

2) 设备购置费

本项目设备测算主要结合公司历史同类设备采购合同价格以及拟采购设备供应商报价综合确定，预计设备购置费 52,394.62 万元，具体设备购置费情况如下：

设备类型	数量（台）	金额
测试机	70	41,458.97
探针台	35	4,039.20
分选机	35	6,896.45
合 计	140	52,394.62

3) 预备费

预备费是针对在项目实施过程中可能发生的难以预料的支出而事先预留的费用。根据项目的实际情况，预估本项目预备费为 974.43 万元，占工程建设及设备购置费用的 0.99%。

4) 铺底流动资金

预计本项目投入铺底流动资金 1,000 万元，占项目总投资的比重约为 1%。

(2) 伟测科技西南总部及研发测试基地项目（西南项目）

西南项目的投资总额为 100,000.00 万元。具体情况如下表所示：

序 号	项目	投资金额	使用本次募集资金金额	募集资金金额占比
1)	建设投资	99,000.00	80,000.00	100.00
①	土地及基础设施建设费用	36,139.69	28,000.00	35.00

序 号	项目	投资金额	使用本次募集资金金额	募集资金金额占比
②	设备购置费	61,338.55	52,000.00	65.00
③	预备费	1,521.76		
2)	铺底流动资金	1,000.00		
合 计		100,000.00	80,000.00	100.00

1) 土地及基础设施建设费用

土地及基础设施建设包括相关土地使用权的出让金、厂房土建和机电工程等，具体投资构成、测算过程及测算依据如下：

序 号	项目	投资金额	测算依据
1	土地	1,080.00	参考成都高新区同区域工业用地公开出让成交价格测算，最终以土地出让合同为准
2	厂房土建	14,008.76	参考公司已实施上海、无锡、南京同类芯片测试洁净厂房造价水平，结合成都当地建筑市场造价、本项目建设规模及洁净厂房建设标准测算
3	机电工程	17,623.92	参考公司已建同类测试厂房机电配套指标，结合本项目工艺设备用电、洁净通风需求，对标成都地区同类型厂房机电造价测算
4	装修	1,427.00	参考公司已实施无锡、南京同类项目装修标准
5	变电站	2,000.00	依据项目用电负荷需求，参考区域工业配套变电站市场造价水平测算
合 计		36,139.69	

公司本次募投项目中土地及基础设施建设费用与公司前次可转债项目（无锡项目和南京项目）、利扬芯片可转债项目对比如下：

单位：平方米、万元、万元/平方米

序 号	上海项目	西南项目	无锡项目	南京项目	利扬芯片可转债项目
新建建筑面积	77,263.00	90,379.10	61,020.00	55,373.00	25,572.00
土地建设费用	20,200.00	14,008.76	10,700.00	12,225.00	4,091.66
装修费用（含机电工程）	18,119.95	19,050.92	15,255.92	12,511.43	3,963.10
单位土地建设费用	0.26	0.16	0.18	0.22	0.16
单位建筑装修费用	0.23	0.21	0.25	0.23	0.15

对比各募投项目单位土地建设费用，上海项目 0.26 万元/m²、南京项目 0.22 万元/m²、无锡项目 0.18 万元/m²，西南项目 0.16 万元/m²，同行业利扬芯片可转债项目为 0.16 万元/m²。不同项目单位土地建设费用存在差异，主要受项目所

在地建材价格、人工成本等区域因素影响，各项目造价水平具备公允性。

对比各募投项目单位建筑装饰费用，公司上海项目、南京项目 0.23 万元/m²，无锡项目 0.25 万元/m²，西南项目 0.21 万元/m²。西南项目造价略低于上海、无锡、南京项目，主要受益于成都本地人工、建材成本相对更低。同行业利扬芯片可转债项目单位建筑装饰费用 0.15 万元/m²，公司项目单位建筑装饰费用整体处于 0.21-0.25 万元/m²区间，整体偏高，主要系公司项目为高标准芯片测试洁净厂房，对洁净度、通风排风、温湿度控制、防微振及特种机电配套要求更高，而利扬芯片项目提供中端芯片测试服务，对洁净厂房建设标准相对较低。因此，本次西南项目单位土地装修费用测算具备合理性。

2) 设备购置费

本项目设备测算主要结合公司历史同类设备采购合同价格以及拟采购设备供应商报价综合确定，预计设备购置费 61,338.55 万元，具体设备购置费情况如下：

设备类型	数量（台）	金额
测试机	90	47,191.39
探针台	45	5,227.39
分选机	45	8,919.77
合 计	180	61,338.55

3) 预备费

预备费是针对在项目实施过程中可能发生的难以预料的支出而事先预留的费用。根据项目的实际情况，预估本项目预备费为 1,521.76 万元，占工程建设及设备购置费用的 1.54%。

4) 铺底流动资金

预计本项目投入铺底流动资金 1,000 万元，占项目总投资的比重约为 1%。

2. 相关测算与公司前次募投项目及同行业公司可比项目的对比情况，是否存在重大差异

相关测算与公司前次募投项目及同行业公司可比项目对比情况如下表所示：

项 目	上海项目	占比（%）	西南项目	占比（%）	无锡项目（前次）	占比（%）	南京项目（前次）	占比（%）	利扬芯片可转债项目	占比（%）
土地及基础设施建设费用	44,370.95	44.94	36,139.69	36.14	29,138.92	29.51	28,150.38	31.28	8,306.95	6.32
设备购置费	52,394.62	53.06	61,338.55	61.34	67,038.00	67.89	60,305.38	67.01	113,236.50	86.10
预备费	974.43	0.99	1,521.76	1.52	1,563.08	1.58	544.24	0.60	6,077.17	4.62
铺底流动资金	1,000.00	1.01	1,000.00	1.00	1,000.00	1.01	1,000.00	1.11	3,899.00	2.96
合 计	98,740.00	100.00	100,000.00	100.00	98,740.00	100.00	90,000.00	100.00	131,519.62	100.00

本次募投项目与公司前次募投项目均包含土地购置、场地平整、土建、厂房洁净装修及配套基础设施建设等完整建设内容。两次募投的四个项目实施地点各不相同，受土地取得成本、地方配套及当地工程造价水平影响，土地与基础设施建设费用占比略有区别，但各分项投资构成比例整体相近。

利扬芯片可转债募投项目依托其已有的自有土地新建厂房实施，土地取得、厂房土建投入未纳入募投测算，因此其土地及基础设施建设费用占比偏低，导致募集资金用于设备购置的比例较高。公司与同行业可比公司利扬芯片可转债项目的差异系项目土地厂房获取方式导致的募集资金投资细项占比不同，具备合理性。

综上，本次募投相关测算与公司前次募投项目土建投资占比略有区别，整体相近，与同行业可比公司利扬芯片可转债项目存在差异，但具备合理性。

(二) 本次募投项目效益测算中测试单价、时长等指标选取的主要依据，与公司现有产品及可比公司同类产品是否存在重大差异，新增折旧摊销对公司未来业绩的影响，本次效益测算是否谨慎、合理

1. 测试单价的选取依据及与公司现有产品及可比公司同类产品是否存在重大差异

(1) 测试单价的选取依据

在本次募投效益测算中，各测试机的每小时测试单价的选取，均参考了公司同型号设备的实际报价。

(2) 测试单价的选取依据及与公司现有产品是否存在重大差异

如上文所述，在本次募投效益测算中，各测试机的每小时测试单价的选取，均参考了公司同型号同配置设备的实际报价，与公司现有产品不存在重大差异。

(3) 测试单价与可比公司同类产品是否存在重大差异

各测试机的每小时测试单价属于测试企业的高等级商业机密，公开渠道无法获取与本项目测算口径匹配的测试单价数据，故无法直接与可比公司同类产品单价进行同口径对比。

2. 测试时长的选取依据及与公司现有情况及可比公司情况对比

(1) 测试时长的选取依据

公司系测试服务供应商，按测试时长收费，测试时长相当于公司的可用产能。公司本次募投效益测算使用的测试时长计算公式为：测试时长=24 小时*360 天*90%。其中，24 小时源于公司测试机全天运行，360 天是为简化计算选取的全年运行天数，考虑到测试平台在运转过程中存在检修、维护等因素，故测试时长以全年时长的 90%计算。

(2) 测试时长与公司现有产品是否存在重大差异

本次募投项目效益测算所使用的测试时长公式与公司 IPO 及前次可转债募投效益测算所使用的测试时长公式一致。

(3) 测试时长与可比公司同类产品是否存在重大差异

公司及可比公司用于计算测试时长的公式如下：

公司名称	测试时长计算公式
利扬芯片	$\Sigma \text{各月末测试平台数量} / 12 * \text{年度运转工作天数} * 24 \text{ 小时} * 80\%$

公司名称	测试时长计算公式
朗迅科技	Σ （各月测试平台数量*24 小时*当月天数）*90%-研发用时
伟测科技	Σ （各月测试平台数量*24 小时*当月天数）*90%

如上表所述，公司测试时长的计算方法与同行业可比公司基本相同，主要区别在于个别参数的设置上存在差异，具体分析如下：①利扬芯片运行效率的取值为 80%，而公司为 90%，主要因为公司产品档次更高，单位产品测试时间更长，中途切换的次数更少，能够实现更高的作业效率，因此根据历史的实际运行情况将该指标设置为 90%，该取值与另一可比公司朗迅科技一致。②朗迅科技的计算公式存在“扣减研发用时”的项目，而公司不存在该项目，主要因为公司拥有独立的研发设备，与生产设备不存在混用的情形，因此不需要扣减研发用时。

3. 新增折旧摊销对公司未来业绩的影响

本次募投项目完全达产后，相关折旧、摊销等费用对财务状况和经营业绩的影响情况如下：

项 目	上海项目	西南项目
每年新增折旧摊销总额	7,458.01	7,940.84
每年新增营业收入	28,551.53	31,543.34
折旧摊销占预计营业收入比重（%）	26.12	25.17

本次上海项目与西南项目完全达产后，预计每年新增折旧摊销占本次募投项目新增营业收入的比重分别为 26.12%和 25.17%。通过本次募投项目的实施，公司将扩张集成电路测试产能，尤其是 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试产能，提升测试方案开发能力，增强核心技术水平和产品竞争力，促进主营业务发展与科技创新水平持续提升。未来公司将持续加大研发投入，重点针对 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试等方向，着重突破各类芯片的测试难点，为公司持续发展注入新动能。公司募投项目前景良好，新增产能预计能够较好地消化，有望进一步提升公司的持续盈利能力。

4. 本次效益测算是否谨慎、合理

本次募投效益测算预测期内的完全达产后毛利率如下：

募投项目名称	上海项目	西南项目	利扬芯片可转债募投项目
预测达产毛利率（%）	50.82	50.32	63.58

公司最近三年高端测试平台毛利率情况如下：

盈利指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
公司高端测试机型毛利率（%）	47.74	47.08	48.14

与公司的历史情况相比，本次两个募投项目的收入基本来自高端测试平台，其收入占比超过 90%，项目毛利率在 50%左右，略高于公司高端测试业务过去三年约 48%的平均水平，主要因为本次募投项目的 AI 算力芯片测试业务的占比更高，并且高端测试平台的档次亦高于公司现有水平，因此具有合理性。

与同行业可比公司相比，本次两个项目的毛利率低于利扬芯片可转债募投项目水平，因此是谨慎和合理的。

本次募投效益测算的内部收益率与可比公司对比情况如下：

项目名称	内部收益率（%）
利扬芯片 2023 年可转债项目	18.94
公司本次募投项目-上海项目	16.03
公司本次募投项目-西南项目	16.17

如上表所示，本次上海项目及西南项目的内部收益率分别为 16.03%和 16.17%，低于同行业可比公司利扬芯片 2023 年可转债项目，效益测算谨慎。

综上所述，本次募投项目效益测算的单价、测试时长等主要指标的选取是合理的，效益测算的结果是谨慎的。

（三）结合公司货币资金余额、资产负债结构等，说明本次融资的必要性、融资规模的合理性

综合考虑公司使用受限的货币资金余额、未来三年预计经营活动现金流量净额，最低现金保有量、未来三年预计新增最低现金保有量、有息负债等项目，公司整体资金缺口预计为 33.65 亿元，本次募集资金与未来三年资金需求相匹配，本次募集资金总额 20 亿元未超过公司总体资金缺口，融资必要、规模合理。具体测算过程如下：

序 号	项 目	计算公式	金额
1	2025 年末货币资金及交易性金融资产余额	①	41,305.05
2	其中：报告期末使用受限货币资金	②	28.62
3	可自由支配资金余额	③=①-②	41,276.43

序 号	项 目	计算公式	金 额
4	未来期间经营活动产生的现金流量净额	④	366,243.79
5	最低现金保有量需求	⑤	43,421.94
6	未来期间新增最低现金保有量需求	⑥	51,976.06
7	未来期间预计现金分红	⑦	65,869.63
8	未来期间偿还有息债务利息	⑧	17,766.53
9	未来资本性项目支出需求	⑨	565,031.48
10	未来资金需求合计	⑩=⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	744,065.63
11	总体资金缺口	⑪=⑩-④-③	336,545.41

1. 可自由支配资金

截至 2025 年末，公司可自由支配的资金情况如下：

项 目	计算公式	金 额
货币资金及交易性金融资产	①	41,305.05
其中：受限货币资金	②	28.62
可自由支配资金	③=①-②	41,276.43

2. 未来期间经营活动产生的现金流量净额

以报告期内财务数据为基础，综合考虑历史上销售商品、提供劳务收到的现金以及购买商品、接受劳务支付的现金等分别与营业收入、营业成本的关系，采用直接法对未来期间经营性现金流入净额进行测算。

(1) 营业收入与营业总成本

最近三年，公司营业收入分别为 73,652.48 万元、107,686.99 万元和 157,464.24 万元，年复合增长率达到 46.22%。基于谨慎性原则，假设公司未来三年的营业收入按 30% 增长。

项 目	2026 年度	2027 年度	2028 年度
营业收入	204,703.51	266,114.57	345,948.94
营业总成本	172,128.71	223,767.33	290,897.53

(2) 经营活动现金流入预计

未来三年的经营活动现金流入基于公司 2025 年度经营活动现金流入占营业收入比例测算：2025 年度，公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例为 93.56%；公司收到其他与经营活动有关的现金占营业收入的比例为 2.79%。

(3) 经营活动现金流出预计

未来三年的经营活动现金流出基于公司 2025 年度经营活动现金流出占营业总成本的比例测算：2025 年度，公司购买商品、接受劳务支付的现金占营业成本的比例为 24.42%；公司支付给职工及为职工支付的现金占营业成本的比例为 31.37%；公司支付的各项税费占营业成本的比例为 2.34%；公司支付其他与经营活动有关的现金占营业成本的比例为 3.12%。

基于以上假设及预估的财务数据测算的未来三年公司经营活动现金流入净额合计约为 366,243.79 万元，具体情况如下：

项 目	2026 年度	2027 年度	2028 年度
营业收入	204,703.51	266,114.57	345,948.94
营业总成本	172,128.71	223,767.33	290,897.53
销售商品、提供劳务收到的现金	191,527.92	248,986.30	323,682.19
收到其他与经营活动有关的现金	5,715.71	7,430.43	9,659.56
经营活动现金流入小计	197,243.64	256,416.73	333,341.75
购买商品、接受劳务支付的现金	42,039.17	54,650.92	71,046.19
支付给职工及为职工支付的现金	54,000.26	70,200.34	91,260.45
支付的各项税费	4,036.00	5,246.80	6,820.85
支付其他与经营活动有关的现金	5,377.78	6,991.11	9,088.45
经营活动现金流出小计	105,453.21	137,089.18	178,215.93
经营活动产生的现金流量净额	91,790.42	119,327.55	155,125.82
2026 年至 2028 年经营活动现金流量净额合计	366,243.79		

3. 最低现金保有量

最低现金保有量系公司为维持其日常营运所需要的最低货币资金金额，以应对客户回款不及时的情况，及支付供应商货款、员工薪酬、税费等短期付现成本。为保证公司平稳运行，确保在客户未及时回款的情况下公司基本性的现金支出需要能够得到满足。最近三年，公司可自由支配资金余额除以各期月均经营活动现金支出分别为 12.25 个月、7.62 个月和 6.11 个月，平均为 8.66 个月。具体如下：

项 目	计算公式	2025 年度 /2025 年末	2024 年度 /2024 年末	2023 年度 /2023 年末
货币资金及交易性金融资产	①	41,305.05	41,401.94	36,212.75
其中：受限货币资金	②	28.62	5,146.17	
可自由支配资金	③=①-②	41,276.43	36,255.78	36,212.75
经营活动现金流出小计	④	81,117.86	57,106.51	35,463.38
月均经营活动现金支出	⑤=④/12	6,759.82	4,758.88	2,955.28
覆盖月份数（月）	⑥=③/⑤	6.11	7.62	12.25
平均覆盖月份（月）	8.66			

根据公司目前可自由支配的资金覆盖的情况，结合公司经营管理经验、现金收支以及未来三年公司经营情况等，基于谨慎性原则，假设最低现金保有量为公司 9 个月的经营活动现金流出资金，最低现金保有量需求为 43,421.94 万元。具体测算如下：

项 目	计算公式	金额
2023 年至 2025 年经营活动现金流出累计金额	①	173,687.74
2023 年至 2025 年月份数（月）	②	36
2023 年至 2025 年月均经营活动现金流出	③=①/②	4,824.66
最低现金保有量需求	④=③*9	43,421.94

4. 新增最低现金保有量

最低现金保有量需求与公司经营规模相关，假设最低现金保有量的增速与营业收入增速一致。结合目前市场需求情况与未来发展趋势，基于谨慎性原则，假设公司未来三年的营业收入按 30.00% 的增长率保持增长，公司未来三年新增最低现金保有量需求为 51,976.06 万元，具体测算过程如下：

项 目	计算公式	金额
最低现金保有量需求	①	43,421.94
未来三年末最低现金保有量	②=①×（1+30.00%） ³	95,397.99
未来三年新增最低现金保有量需求	③=②-①	51,976.06

5. 未来期间预计分红

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

项 目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	30,319.86	12,822.88	11,799.63
现金分红金额（含税）	9,244.86	3,881.43	3,627.97

最近三年，公司累计现金分红金额为 16,754.26 万元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润复合增长率为 60.30%。基于谨慎性原则，假设公司未来三年现金分红按照 50.00% 增长，预计公司未来三年分红合计 65,869.63 万元。

6. 未来期间偿还有息债务利息

截至 2025 年末，公司短期借款余额 46,229.90 万元，一年内到期的长期借款余额 30,413.38 万元，长期借款余额 197,529.05 万元。截至 2025 年末，公司短期借款平均借款利率为 2.18%，长期借款平均借款利率为 2.69%，预计未来三年偿还有息债务利息 17,766.53 万元，具体测算过程如下：

项 目	短期借款	一年内到期的长期借款	长期借款
期末余额	46,229.90	30,413.38	197,529.05
平均借款利率（%）	2.18	2.69	2.69
未来三年利息	1,007.81	818.12	15,940.59
未来三年利息合计	17,766.53		

注：未来三年利息合计=短期借款期末余额*平均借款利率+一年内到期的长期借款期末余额*平均借款利率+长期借款期末余额*平均借款利率*3

7. 未来资本性项目支出

截至本回复出具日，公司已审议的拟投资项目如下：

项目名称	投资金额（亿元）	审议情况
伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目（二期）	13.00	已经第二届董事会第十四次会议审议
车规级控制器元器件测试建设项目	4.50	已经总经理办公会审议
车载激光雷达射频元器件检测设备更新项目	3.50	已经总经理办公会审议
伟测科技上海总部基地项目	9.87	已经第二届董事会第二十九次会议审议
伟测科技西南总部及研发测试基地项目	10.00	已经第二届董事会第二十九次会议审议
合 计	40.87	

上述项目为公司未来三年的主要资本性支出项目，拟投资金额合计 40.87 亿元。鉴于第三方集成电路测试行业属于典型的资本密集型行业，受下游客户需求、

技术快速迭代及公司自身扩产等多重因素驱动，公司需持续进行大规模的固定资产投入。2023-2025 年，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金累计达 56.50 亿元，充分印证了公司持续高强度的投入特征。结合上述已审议项目的资金需求、行业特性以及潜在产能储备规划，并参考报告期内的实际投入规模，公司预计未来三年累计资本性投入为 565,031.48 万元。具体情况如下：

资本性支出	2025 年度	2024 年度	2023 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,598.10	148,277.24	122,156.14
最近三年累计投入金额	565,031.48		
未来三年预计投入金额	565,031.48		

综上，综合考虑公司货币资金余额、资产负债结构等项目，公司未来三年整体资金缺口预计为 33.65 亿元，本次募集资金规模与未来三年资金需求相匹配，本次融资具备必要性、合理性。

（四）核查程序及核查结论

1. 核查程序

针对上述事项，我们主要执行了以下核查程序：

（1）查阅公司报告期内的定期报告、前次募集资金的可行性研究报告、前次募集资金使用情况鉴证报告等资料，并对公司管理层进行访谈，了解本次募集资金投向及具体规划、本次募投项目与公司主营业务及前次募投项目的区别与联系；

（2）查阅同行业上市公司公开披露资料，同行业上市公司相关项目投资构成及测算过程，经济效益及测算过程等；

（3）查阅公司与成都市高新区管理委员会签订的《投资合作协议》及相关补充协议、《成都市住房和城乡建设局等 4 部门关于进一步优化产业园区工业项目开工建设和竣工验收工作的通知》（成住建规〔2025〕1 号）以及“拿地即开工”审批服务流程图，访谈公司管理层，了解伟测科技西南总部及研发测试基地项目土地取得计划、时间安排及目前进展，并分析相关投资协议包含的效益指标是否存在无法达成的风险；

（4）获取本次募投项目的可行性研究报告，了解本次募投项目的具体投资构成、经济效益以及相关测算假设和测算过程情况等；计算新增折旧摊销对公司未来业绩的影响；

(5) 查阅公司报告期内的定期报告，分析公司货币资金余额、资产负债结构等。

2. 核查结论

经核查，我们认为：

(1) 本次募投相关测算与公司前次募投项目土建投资占比略有区别，整体相近，与同行业可比公司利扬芯片可转债项目存在差异，但具备合理性。

(2) 在本次募投效益测算中，各测试机的每小时测试单价的选取，均参考了公司同型号同配置设备的实际报价，与公司现有产品不存在重大差异；各测试机的每小时测试单价属于测试企业的高等级商业机密，公开渠道无法获取与本项目测算口径匹配的测试单价数据，故无法直接与可比公司同类产品单价进行同口径对比。公司本次募投效益测算使用的测试时长与 IPO 及前次可转债募投效益测算相同，测试时长的构成符合行业现状及公司实际情况，本次募投效益测算是谨慎和合理的。

(3) 公司本次融资规模符合公司现有货币资金用途及资产负债情况，本次融资规模未超过公司总体资金缺口，融资具有必要性、融资规模具有合理性。

二、关于业务与经营情况

根据申报材料：（1）2023 年至 2026 年一季度，公司营业收入分别为 73,652.48 万元、107,686.99 万元、157,464.24 万元及 48,997.56 万元，净利润分别为 11,799.63 万元、12,822.88 万元、30,319.86 万元和 7,085.80 万元，主营业务毛利率分别为 38.32%、37.48%、39.01%和 33.51%；（2）2023 年至 2026 年第一季度，公司应收账款账面价值分别为 30,834.29 万元、35,333.86 万元、52,748.12 万元和 54,043.83 万元；（3）2023 年至 2026 年一季度，公司固定资产分别为 196,406.21 万元、288,739.09 万元、412,883.37 万元和 499,379.86 万元，在建工程分别为 51,413.82 万元、66,982.48 万元、158,511.14 万元和 157,644.54 万元。

请发行人说明：（1）结合公司测试服务单价、工时、产能利用率等情况，说明 2023 年至 2026 年第一季度业绩增长的主要原因，与同行业可比公司是否存在重大差异，并说明 2026 年第一季度毛利率下滑的主要原因；（2）应收账款增长的原因及合理性，并结合应收账款账龄结构、主要客户、期后回款等，说明坏

账准备计提是否充分，与同行业可比公司是否存在重大差异；（3）报告期内公司在建工程主要项目的转固时点，是否存在应转固未及时转固的情形，并说明在建工程转固后新增产能的消化情况，是否存在固定资产闲置及减值风险；（4）截至最近一期末，公司是否持有金额较大的财务性投资，本次发行董事会决议日前六个月内公司是否存在新投入和拟投入的财务性投资。

请保荐机构和申报会计师进行核查并发表明确意见。（审核问询函问题 2）

（一）结合公司测试服务单价、工时、产能利用率等情况，说明 2023 年至 2026 年第一季度业绩增长的主要原因，与同行业可比公司是否存在重大差异，并说明 2026 年第一季度毛利率下滑的主要原因

1. 结合公司测试服务单价、工时、产能利用率等情况，说明 2023 年至 2026 年第一季度业绩增长的主要原因

报告期内，公司测试服务单价、工时和产能利用率情况如下：

单位：元/小时、万小时

期 间	晶圆测试单价	芯片成品测试单价	测试总工时	产能利用率 (%)
2026 年 1-6 月	240.64	273.16	390.94	76.67
2025 年度	278.66	230.95	564.10	74.19
2024 年度	221.54	209.92	447.91	76.79
2023 年度	223.89	277.33	275.21	63.27

报告期内，公司不同测试服务类型的工时和产能利用率情况如下：

单位：万小时

期间	晶圆测试		芯片成品测试	
	测试总工时	产能利用率 (%)	测试总工时	产能利用率 (%)
2026 年 1-6 月	205.77	75.52	185.17	78.00
2025 年度	307.28	71.24	256.82	78.04
2024 年度	275.99	74.79	171.92	80.21
2023 年度	197.64	66.55	77.57	56.64

2023 年至 2026 年 1-6 月，公司营业收入分别为 73,652.48 万元、107,686.99 万元、157,464.24 万元及 107,185.98 万元，同比增长分别为 0.48%、46.21%、46.22%及 69.00%，业绩保持快速增长趋势，主要原因分析如下：

2024 年下半年起，集成电路行业进入上游库存去化、下游需求复苏阶段，

大量国产高端芯片和车规级芯片进入量产阶段，市场对高端芯片和高可靠性芯片测试需求明显增加，公司收入结构以高端测试为主，因此业绩复苏以及测试总工时和产能利用率的恢复较为明显，公司测试总工时由 2023 年度的 275.21 万小时上升至 2024 年度的 447.91 万小时，增幅为 62.75%，产能利用率从 63.27% 上升至 76.79%。但由于上一轮行业周期下行带来的单价下降因素尚未完全消除，公司 2024 年度的测试单价较 2023 年度仍呈现下降趋势。

2025 年，受益于 AI、智驾等新兴领域的快速发展，集成电路行业增长强劲，高端测试需求爆发，公司产品结构持续优化，进入价量齐升的阶段：晶圆测试单价由 221.54 元/小时上升至 278.66 元/小时，增幅为 25.78%，晶圆测试总工时由 275.99 万小时上升至 307.28 万小时，增幅为 11.34%。芯片成品测试单价由 209.92 元/小时上升至 230.95 元/小时，增幅较缓，芯片成品测试总工时由 171.92 万小时上升至 256.82 万小时，增幅为 49.38%，增长显著。同时，公司前次可转债募投项目及自筹资金扩产项目于 2025 年陆续投产，新增产能处于爬坡阶段，故 2025 年度公司产能利用率较 2024 年度略有下降，但仍维持在较高水平。

2026 年 1-6 月，AI 推理需求爆发、智能驾驶渗透、大容量存储需求扩张进一步推动公司高端测试需求增长。芯片成品测试单价较上年度增长 42.21 元/小时，增幅为 18.28%，主要系芯片成品测试中高端测试收入占比较上年度提升 8.13 个百分点至 66.26%，且高端芯片成品测试通常需配套三温测试、老化测试和系统级测试，收费标准较高所致。公司晶圆测试单价较上年度下降 38.02 元/小时，降幅为 13.64%，主要系公司应部分客户要求，优化测试流程导致该部分客户测试单价相应降低，加之部分客户需求旺盛，公司给予一定价格优惠所致。同时，公司测试总工时和产能利用率仍维持较高水平，带动公司业绩持续高速增长。

综上，报告期内，公司晶圆测试单价呈波动上升趋势，芯片成品测试单价呈先下降后回升趋势，测试总工时逐年稳定上升且产能利用率均维持在较高水平，上述因素共同驱动公司业绩高速增长。

2. 与同行业可比公司是否存在重大差异

报告期内，公司与同行业可比公司的营业收入及同比增长率情况如下：

公司名称	2026 年 1-6 月	增长率 (%)	2025 年度	增长率 (%)	2024 年度	增长率 (%)	2023 年度
利扬芯片	35,632.85	25.45	61,839.44	26.69	48,812.56	-2.97	50,308.45

公司名称	2026 年 1-6 月	增长率 (%)	2025 年度	增长率 (%)	2024 年度	增长率 (%)	2023 年度
华岭股份	15,930.14	1.05	31,625.82	14.47	27,627.56	-12.43	31,548.96
朗迅科技	未披露	未披露	206,430.25	89.86	108,728.04	103.03	53,553.63
公司	107,185.98	69.00	157,464.24	46.22	107,686.99	46.21	73,652.48

报告期内，公司营业收入同比增长率保持较高水平。2025 年度及 2026 年 1-6 月，公司与同行业可比公司的收入变动均呈上升趋势。2024 年度及 2025 年度，朗迅科技营收增长率显著高于公司，而利扬芯片和华岭股份 2024 年度营业收入呈现下降趋势，主要原因分析如下：

(1) 从测试单价的角度分析，报告期内，公司与可比公司的测试单价情况如下：

公司名称	产品	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
利扬芯片	晶圆测试（元/片）	未披露	未披露	316.10	405.73
	芯片成品测试（元/千颗）	未披露	未披露	144.61	195.85
华岭股份	晶圆测试（元/片）	未披露	未披露	305.42	413.01
	芯片成品测试（元/千颗）	未披露	未披露	322.10	179.17
朗迅科技	晶圆测试（元/小时）	未披露	464.15	432.50	412.16
	芯片成品测试（元/小时）	未披露	758.88	635.77	514.30
公司	晶圆测试（元/小时）	240.64	278.66	221.54	223.89
	芯片成品测试（元/小时）	273.16	230.95	209.92	277.33

注：朗迅科技测试单价系通过当期营业收入除以测试总工时自行计算得出

2024 年，公司晶圆测试和芯片成品测试单价较上年度呈现下降趋势，与可比公司利扬芯片的趋势保持一致，主要系上一轮行业周期下行带来的单价下降因素尚未完全消除所致，但由于公司 2024 年度测试总工时增幅较大，营业收入规模仍保持高速增长的趋势。华岭股份芯片成品测试单价较上年度增幅较高，主要原因是其 2024 年重点拓展了车规级、AI/FPGA、高可靠性芯片的测试业务，这类订单对测试条件（如三温测试、可靠性验证）要求高，单颗测试费远高于消费类芯片；但由于 2024 年度消费类芯片测试需求低迷，同时 IDM 厂商转向自建测试产线，导致其晶圆测试外包订单大幅流失，晶圆测试单价和整体营收仍呈现下降趋势。2024 年，朗迅科技晶圆测试单价及芯片成品测试单价均有所上升，主要系其 2024 年度战略层面主动放弃毛利率较低的低端消费电子芯片散单，聚焦算

力、车载、工业等高毛利客户，订单结构优化直接拉高平均单价，与其较高的营收增长率相匹配。

2025 年，可比公司利扬芯片和华岭股份未披露测试单价数据，故仅比较分析朗迅科技和公司的变动差异。朗迅科技和公司的测试单价均呈现上升趋势，与营收增长趋势保持一致，其中朗迅科技的芯片成品测试单价增幅较大，主要系当年手机 SoC 芯片及 UFS 芯片等测试规模快速增长，相关芯片测试难度和测试单价较高所致。

(2) 从测试工时和产能利用率的角度分析，由于利扬芯片和华岭股份未披露相关数据，因此仅与朗迅科技进行比较分析。报告期内，公司与朗迅科技晶圆测试的测试工时及产能利用率情况如下：

期 间	朗迅科技			伟测科技		
	测试总工时 (万小时)	测试总工时 增长率 (%)	产能利 用率 (%)	测试总工时 (万小时)	测试总工时 增长率 (%)	产能利 用率 (%)
2026 年 1-6 月	未披露	未披露	未披露	206	34 (年化)	76
2025 年度	133	125	88	307	11	71
2024 年度	59	84	78	276	39	75
2023 年度	32	未披露	83	198	10	67

从晶圆测试的角度分析，2023 年至 2025 年，朗迅科技的产能利用率均保持在较高水平，且测试总工时增长率在 2024 年及 2025 年分别达到 84%和 125%，增幅较大，与其高速营收增长相匹配。公司晶圆测试总工时基数相较于朗迅科技整体较高，且公司处于大规模扩产阶段，导致其产能利用率和增长率相对较低，但仍保持稳定增长的趋势，与营收增长相匹配。

报告期内，公司与朗迅科技芯片成品测试的测试工时及产能利用率情况如下：

期 间	朗迅科技			伟测科技		
	测试总工时 (万小时)	测试总工时 增长率 (%)	产能利 用率	测试总工时 (万小时)	测试总工时 增长率 (%)	产能利 用率 (%)
2026 年 1-6 月	未披露	未披露	未披露	185	44 (年化)	78
2025 年度	129	54	76	257	49	78
2024 年度	84	79	73	172	121	80
2023 年度	47	未披露	66	78	-20	57

从芯片成品测试的角度分析，公司 2024 年和 2025 年的产能利用率均高于朗

迅科技，仅 2023 年较低，且公司 2024 年和 2025 年的测试总工时增长率较为显著，与朗迅科技的增长趋势及公司自身营收增长保持一致。

综上，2024 年度利扬芯片、华岭股份受行业周期下行影响，营业收入有所下降，公司及朗迅科技仍保持增长；2025 年以来公司与同行业可比公司营业收入均呈增长趋势，业绩变动方向一致，增速差异主要系各公司产品结构、客户结构及收入基数不同所致，与各自测试单价、测试工时及产能利用率的变化相匹配，具有合理性，公司与同行业可比公司不存在重大差异。

3. 说明 2026 年第一季度毛利率下滑的主要原因

报告期内，公司毛利率情况如下：

财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
主营业务毛利率（%）	32.87	39.01	37.48	38.32
其他业务毛利率（%）	45.98	45.96	33.27	47.81
综合毛利率（%）	33.59	39.37	37.11	38.96

2026 年 1-6 月，公司综合毛利率为 33.59%，较上年度下降 5.78 个百分点；主营业务毛利率为 32.87%，较上年度下降 6.14 个百分点。公司综合毛利率与主营业务毛利率变动趋势一致，具体分析如下：

(1) 行业季节性因素，上半年综合毛利率历来低于全年水平

报告期内，公司上半年综合毛利率和全年综合毛利率情况如下：

项 目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
上半年综合毛利率（%）	33.59	36.43	35.28	41.35
全年综合毛利率（%）		39.37	37.11	38.96

2024 年度、2025 年度，公司上半年综合毛利率均低于全年综合毛利率，该趋势系行业季节性因素所致，属于行业常规经营特征。2023 年度属于特殊情形，当年集成电路测试行业处于下行周期，下半年行业景气度持续走弱，使得全年综合毛利率低于上半年水平，不具代表性。

(2) 持续扩产，新增产能爬坡，导致刚性固定成本支出较高

报告期内，公司产能利用率分别为 63.27%、76.79%、74.19%和 76.67%。2025 年度，公司前次可转债募投项目及自筹资金扩产项目陆续投产，新增产能尚未完全释放，处于爬坡阶段。2026 年 1-6 月，公司持续扩大集成电路测试产能，平均设备数量由 2025 年上半年的 861 台增长至 2026 年上半年的 1,244 台，增幅为

44.48%，相关折旧、能源费用等刚性固定成本已开始计入，导致设备折旧及租赁费用、能源费用较上年同期分别增长 10,764.65 万元和 2,111.72 万元，增幅分别为 57.06%和 51.29%，进而推动 2026 年上半年公司主营业务成本增长较大。

综上，报告期内，公司综合毛利率分别为 38.96%、37.11%、39.37%和 33.59%，其中 2026 年 1-6 月综合毛利率下降较为明显，主要系行业季节性因素及新增产能爬坡影响所致。

（二）应收账款增长的原因及合理性，并结合应收账款账龄结构、主要客户、期后回款等，说明坏账准备计提是否充分，与同行业可比公司是否存在重大差异

1. 应收账款增长的原因及合理性

报告期各期末，公司应收账款及营业收入情况如下：

项 目	2026 年 1-6 月 /2026.6.30	2025 年度 /2025.12.31	2024 年度 /2024.12.31	2023 年度 /2023.12.31
应收账款账面余额	61,010.41	55,527.99	37,205.29	32,479.79
应收账款坏账准备	3,054.50	2,779.88	1,871.42	1,645.50
应收账款账面价值	57,955.91	52,748.12	35,333.86	30,834.29
增长率（%）	9.87	49.28	14.59	
营业收入	107,185.98	157,464.24	107,686.99	73,652.48

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 30,834.29 万元、35,333.86 万元、52,748.12 万元和 57,955.91 万元，整体呈上涨趋势。报告期各期末，公司应收账款增加的主要原因系公司 IPO、前次可转债募投项目及自筹资金项目陆续投产，带动营业收入持续增长。报告期内，公司应收账款与营业收入变动趋势一致，具备商业合理性。

综上，公司报告期各期末应收账款的增长具备合理性。

2. 结合应收账款账龄结构、主要客户、期后回款等，说明坏账准备计提是否充分，与同行业可比公司是否存在重大差异

（1）应收账款账龄结构

报告期各期末，公司应收账款账龄结构如下：

1) 2026 年 6 月 30 日

账 龄	账面余额	占比（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	60,930.84	99.87	3,046.54	57,884.29

账 龄	账面余额	占比 (%)	坏账准备	账面价值
1-2 年	79.58	0.13	7.96	71.62
合 计	61,010.41	100.00	3,054.50	57,955.91

2) 2025 年 12 月 31 日

账 龄	账面余额	占比 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	55,458.46	99.87	2,772.92	52,685.54
1-2 年	69.53	0.13	6.95	62.58
合 计	55,527.99	100.00	2,779.88	52,748.12

3) 2024 年 12 月 31 日

账 龄	账面余额	占比 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	36,982.36	99.40	1,849.12	35,133.24
1-2 年	222.85	0.60	22.29	200.57
2-3 年	0.07		0.02	0.05
合 计	37,205.29	100.00	1,871.42	35,333.86

4) 2023 年 12 月 31 日

账 龄	账面余额	占比 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	32,221.74	99.23	1,611.09	30,610.65
1-2 年	248.42	0.77	24.84	223.58
2-3 年	0.07		0.02	0.05
合 计	32,470.24	100.00	1,635.95	30,834.29

注：2023 年 12 月 31 日应收账款账面余额为账龄组合下应收账款余额

报告期各期末，公司应收账款账龄以 1 年以内为主，占比均在 99%以上，账龄较短，应收账款安全性高，不能收回的可能性较小。

(2) 主要客户

报告期各期末，公司应收账款前五大客户情况如下：

1) 2026 年 6 月 30 日

客户名称	账面余额	占应收账款 余额比例 (%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
客户 A	9,594.93	15.73	479.75	5.00

客户名称	账面余额	占应收账款 余额比例(%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
客户 C	4,344.90	7.12	217.24	5.00
矽品科技（苏州）有限公司	3,796.72	6.22	189.84	5.00
紫光展锐（上海）科技股份有限公司	3,690.38	6.05	185.41	5.02
合肥智芯半导体有限公司	3,655.35	5.99	182.78	5.00
合 计	25,082.28	41.11	1,255.01	5.00

2) 2025 年 12 月 31 日

客户名称	账面余额	占应收账款 余额比例(%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
客户 A	8,380.06	15.09	419.00	5.00
客户 C	5,339.80	9.62	266.99	5.00
展讯通信（上海）有限公司	4,452.83	8.02	222.64	5.00
客户 B	3,282.26	5.91	164.11	5.00
合肥智芯半导体有限公司	3,053.74	5.50	152.69	5.00
合 计	24,508.69	44.14	1,225.43	5.00

3) 2024 年 12 月 31 日

客户名称	账面余额	占应收账款 余额比例(%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
客户 A	8,172.45	21.97	408.62	5.00
展讯通信（上海）有限公司	2,936.18	7.89	146.81	5.00
客户 B	2,592.62	6.97	129.63	5.00
客户 C	2,100.46	5.65	105.02	5.00
无锡英迪芯微电子科技股份有限公司	1,035.55	2.78	51.78	5.00
合 计	16,837.25	45.26	841.86	5.00

4) 2023 年 12 月 31 日

客户名称	账面余额	占应收账款 余额比例(%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
客户 B	3,570.02	10.99	178.50	5.00

客户名称	账面余额	占应收账款 余额比例(%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
紫光展锐（上海）科技有限公司	2,579.77	7.94	128.99	5.00
深圳市中兴微电子技术有限公司	2,472.37	7.61	123.62	5.00
客户 A	2,121.16	6.53	106.06	5.00
合肥智芯半导体有限公司	2,028.84	6.25	101.44	5.00
合 计	12,772.17	39.32	638.61	5.00

报告期各期末，公司应收账款前五大客户的合计应收账款余额为 12,772.17 万元、16,837.25 万元、24,508.69 万元和 25,082.28 万元，占各期末应收账款余额的比例分别为 39.32%、45.26%、44.14%和 41.11%，主要应收账款对象集中度总体保持稳定。

报告期各期末，公司前五大应收账款客户均按账龄组合计提坏账准备，坏账准备计提充分，主要客户整体信用风险可控，未发生显著异常。

(3) 期后回款

报告期各期末，公司应收账款账龄、期后回款情况如下：

期 间	账龄	账面余额	占比 (%)	截至 2026 年 8 月 末,期后回款金额	期后回款 比例 (%)
2026 年 6 月末	1 年以内	60,930.84	99.87	37,903.02	62.13
	1-2 年	79.58	0.13		
	合 计	61,010.41	100.00		
2025 年末	1 年以内	55,458.46	99.87	53,537.47	96.42
	1-2 年	69.53	0.13		
	合 计	55,527.99	100.00		
2024 年末	1 年以内	36,982.36	99.40	37,205.28	100.00
	1-2 年	222.85	0.6		
	2-3 年	0.07			
	合 计	37,205.29	100.00		
2023 年末	1 年以内	32,221.74	99.23	32,470.24	100.00
	1-2 年	248.42	0.77		
	2-3 年	0.07			

期 间	账龄	账面余额	占比（%）	截至 2026 年 8 月 末,期后回款金额	期后回款 比例（%）
	合 计	32,470.24	100.00		

注：2024 年末，核销应收账款 9.55 万元；2023 年 12 月 31 日应收账款账面余额为账龄组合下应收账款余额

报告期各期末，公司应收账款账龄在 1 年以内的占比分别为 99.23%、99.40%、99.87%及 99.87%，报告期各期末应收账款账龄结构稳定，未发生重大变化。

报告期各期末，公司应收账款期后回款比例分别为 100.00%、100.00%、96.42%及 62.13%。2024 年末，公司核销应收账款 9.55 万元，主要系诺领科技（南京）有限公司处于清算状态，核销无法收回的芯片成品测试款。除上述情况外，公司应收账款总体回款率较高、账龄较短、坏账计提充分，不能收回的可能性较小。

(4) 同行业可比公司坏账准备计提情况

1) 公司与台资可比公司的坏账计提政策

京元电子		矽格		欣铨	
类 别	计提比例 （%）	类别	计提比例 （%）	类别	计提比例 （%）
未逾期	0	未逾期	0.001	未披露	未披露
逾期 1-90 天	0	逾期 30 天内	0.001	未披露	未披露
逾期 91-180 天	1	逾期 31-90 天内	30	未披露	未披露
逾期 181-365 天	2	逾期 91-180 天内	50	未披露	未披露
逾期 366 天以上	5	逾期 180 天以上	50~100	未披露	未披露

2) 公司与内资可比公司的坏账计提政策

类 别	利扬芯片（%）	华岭股份（%）	朗迅科技（%）	公司（%）
1 年以内	3	3	5	5
1-2 年	10	5	10	10
2-3 年	30	10	30	30
3-4 年	100	50	50	50
4-5 年	100	80	80	80
5 年以上	100	100	100	100

由上表可知，3 家台资可比公司的坏账计提政策的方法与公司不一致，不具有可比性。公司各期末的应收账款基本分布在 1 年以内和 1-2 年，公司的坏账计

提比例与朗迅科技一致，与利扬芯片、华岭股份 2 家内资可比公司相比，公司的坏账计提比例更加谨慎、保守。

综上，公司报告期各期末应收账款坏账准备计提充分，与同行业可比公司相比不存在重大差异。

（三）报告期内公司在建工程主要项目的转固时点，是否存在应转固未及时转固的情形，并说明在建工程转固后新增产能的消化情况，是否存在固定资产闲置及减值风险

1. 报告期内公司在建工程主要项目的转固时点，是否存在应转固未及时转固的情形

报告期内，公司在建工程主要项目如下：

（1）2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末

项目名称	期初余额	增加金额	转入固定资 产金额	其他减少金 额	期末余额
测试设备	150,084.54	158,477.54	173,621.27		134,940.81
上海厂务工程	4,323.78	12,142.43			16,466.21
无锡厂务工程	2,729.79	960.31	820.79	217.43	2,651.89
南京厂务工程	185.67	188.22	185.67	139.51	48.71
合 计	157,323.79	171,768.51	174,627.73	356.94	154,107.63

（2）2025 年度/2025 年末

项目名称	期初余额	增加金额	转入固定资 产金额	其他减少金 额	期末余额
测试设备	55,719.28	237,998.42	143,633.16		150,084.54
上海厂务工程	311.91	4,291.04		279.17	4,323.78
无锡厂务工程	10,239.83	23,995.99	31,397.18	108.84	2,729.79
南京厂务工程	326.23	1,805.29	1,696.09	249.75	185.67
合 计	66,597.25	268,090.74	176,726.44	637.76	157,323.79

（3）2024 年度/2024 年末

项目名称	期初余额	增加金额	转入固定资 产金额	其他减少金 额	期末余额
测试设备	31,743.58	120,783.95	96,808.24		55,719.28
无锡厂务工程	1,431.24	10,244.09	1,014.27	421.23	10,239.83
南京厂务工程	17,690.67	8,299.15	25,177.70	485.89	326.23

项目名称	期初余额	增加金额	转入固定资产 金额	其他减少金 额	期末余额
合 计	50,865.49	139,327.18	123,000.21	907.12	66,285.34

(4) 2023 年度/2023 年末

项目名称	期初余额	增加金额	转入固定资产 金额	其他减少金 额	期末余额
测试设备	10,854.65	98,828.04	77,939.11		31,743.58
南京厂务工程	549.87	17,346.81		206.01	17,690.67
合 计	11,404.52	116,174.85	77,939.11	206.01	49,434.25

报告期内，公司在建工程主要包括测试设备及厂务工程。具体情况如下：

1) 报告期内，公司在建工程中的测试设备主要包括尚在安装或功能验证阶段的测试机、探针台、分选机和外观检查机等。报告期内，公司测试设备的转固时点为设备达到预定可使用状态，判断标准为设备完成装机且通过功能验证；测试设备转固的依据为《设备验收单》，该《设备验收单》经权责主管核准后送交财务部，财务部将《设备验收单》留存并将该设备转入固定资产核算，自验收完成次月起计提折旧。公司报告期内主要测试设备均需安装及功能验证后方可投入使用，转入固定资产的周期一般为 1-4 个月，转入固定资产的时点及时，不存在已达预定可使用状态未及时转固的情形。

2) 报告期内，公司在建工程中的厂务工程的转固时点为达到预定可使用状态，判断标准为工程施工完成，并通过工程竣工验收；转固依据为《竣工验收单》，财务部留存验收资料并将对应的厂务工程转入固定资产核算，自验收完成次月起计提折旧。报告期内，公司厂务工程的转固时长主要受到项目规模大小影响，转入固定资产的依据充分，时点及时，不存在已达预定可使用状态未及时转固的情形。

综上，报告期内公司在建工程主要项目的转固时点为达到预定可使用状态，不存在应转固未及时转固的情形。

2. 说明在建工程转固后新增产能的消化情况，是否存在固定资产闲置及减值风险

报告期各期末，公司产能及营业收入情况如下：

项 目	2026 年 1-6 月 /2026/6/30	2025 年度 /2025/12/31	2024 年度 /2024/12/31	2023 年度 /2023/12/31
产能（万小时）	509.89	760.39	583.32	433.95

项 目	2026 年 1-6 月 /2026/6/30	2025 年度 /2025/12/31	2024 年度 /2024/12/31	2023 年度 /2023/12/31
新增产能（万小时）	259.39（年化）	177.07	149.37	67.01
产能利用率（%）	76.67	74.19	76.79	63.27
营业收入	107,185.98	157,464.24	107,686.99	73,652.48

报告期各期末，公司产能分别为 433.95 万小时、583.32 万小时、760.39 万小时和 509.89 万小时；对应新增产能分别为 67.01 万小时、149.37 万小时、177.07 万小时和 259.39 万小时（年化）。受益于 IPO 及前次可转债募投项目、自筹资金投资项目的逐步投产，公司产能规模持续扩张，新增产能随着公司 AI 算力芯片测试等业务规模的拓展逐步消化，最近一期产能利用率达 76.67%。报告期内，公司营业收入分别为 73,652.48 万元、107,686.99 万元、157,464.24 万元和 107,185.98 万元，同比增速分别为 0.48%、46.21%、46.22%和 69.00%，营业收入亦随着产能释放实现较快增长。

报告期内，公司新增固定资产主要为高端测试设备，不存在固定资产闲置及减值的风险。

综上，公司报告期内新增产能得到有效消化，新增固定资产主要为高端测试设备，不存在闲置及减值的风险。

（四）截至最近一期末，公司是否持有金额较大的财务性投资，本次发行董事会决议日前六个月内公司是否存在新投入和拟投入的财务性投资

1. 截至最近一期末，公司是否持有金额较大的财务性投资

截至 2026 年 6 月 30 日，公司财务报表中可能涉及财务性投资的相关科目情况如下：

项 目	金额	主要构成	是否属于财务性投资
交易性金融资产	6,054.62	中低风险理财产品	否
预付账款	511.87	保险费及采购款	否
其他应收款	1,319.49	押金保证金、员工购房借款	否
其他流动资产	72,289.88	增值税待抵扣进项税	否
其他非流动金融资产	5,000.00	对江苏泰治的股权投资	否
	500.00	对芯知微的股权投资	否
	2,865.88	对上海信邀的股权投资	是

项 目	金额	主要构成	是否属于财务性投资
其他非流动资产	15,144.88	预付设备工程款	否

(1) 交易性金融资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产账面价值为 6,054.62 万元，主要系公司购入的理财产品，相关理财产品明细（不含收益）具体如下：

产品名称	产品风险	本金金额（万元）	购买日期	期限	预期年化收益率/业绩比较基准
招银理财招赢日日金 181 号现金管理类理财计划	低风险	1,000.00	2026 年 5 月 26 日	无固定期限 T+1	1.46%
省心享-华泰 WUFUND 固收私享 FOF721 号单一资产管理计划	中低风险	1,000.00	2025 年 9 月 25 日	锁定 180 天后 可赎回	2.3%-2.5%
		2,000.00	2026 年 1 月 9 日		
		1,000.00	2026 年 4 月 24 日		
国寿资产-源流 2158 保险资产管理产品	中低风险	1,000.00	2026 年 1 月 9 日	锁定 7 天后 可赎回	1.8%-2.0%

公司基于日常资金管理的目的购买理财产品，所购买的理财产品为银行现金管理类产品、券商保险固定收益类资管产品，不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。

(2) 预付账款

截至 2026 年 6 月末，公司持有的预付账款账面价值为 511.87 万元，主要系公司预付保险费 106.42 万元。其余预付账款为账龄在一年以内的尚未与供应商办理结算的预付采购款，不属于财务性投资。

(3) 其他应收款

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面价值为 1,319.49 万元，主要包括日常生产经营活动相关的押金保证金及员工购房借款，不属于财务性投资。

(4) 其他流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他流动资产账面价值为 72,289.88 万元，主要包括待抵扣增值税、待售测试硬件及预缴企业所得税等，均系公司经营活动形成，不属于财务性投资。

(5) 其他非流动金融资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融资产账面价值为 8,365.88 万

元，主要系对江苏泰治科技股份有限公司、蚌埠芯知微电子科技有限公司和上海信邀创业投资中心（有限合伙）的股权投资。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司对江苏泰治的投资账面价值为 5,000.00 万元。江苏泰治为半导体行业的智能制造解决方案服务商，公司对江苏泰治的投资属于围绕半导体产业链上游，以获取技术和业务合作为目的产业投资，不属于财务性投资。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司对芯知微的投资账面价值为 500.00 万元。芯知微主要从事集成电路芯片设计及服务，公司对芯知微的投资属于围绕半导体产业链下游客户，以加强业务合作和拓展客户渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司对上海信邀的投资账面价值为 2,865.88 万元，上海信邀主要从事半导体产业链相关的股权投资业务，该笔投资属于财务性投资，占期末合并报表归属于母公司净资产 422,791.61 万元的比例为 0.68%。

（5）其他非流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产账面价值为 15,144.88 万元，主要系预付设备工程款及软件购置款，不属于财务性投资。

综上，截至 2026 年 6 月 30 日，除对上海信邀的投资外，公司不存在其他财务性投资。公司财务性投资总金额 2,865.88 万元，占合并报表归属于母公司净资产 422,791.61 万元的比例为 0.68%，比例较低。

2. 本次发行董事会决议日前六个月内公司是否存在新投入和拟投入的财务性投资

本次发行董事会决议日为 2026 年 5 月 8 日，本次发行董事会决议日前六个月至本回复签署日，公司不存在新投入和拟投入的财务性投资，具体如下：

（1）投资类金融业务

自本次发行董事会决议日前六个月至本回复签署日，公司不存在投入类金融业务的情形，亦无拟投入类金融业务的计划。

（2）非金融企业投资金融业务

自本次发行董事会决议日前六个月至本回复签署日，公司不存在投资金融业务的情况，亦无拟投资金融业务的计划。

（3）对外股权投资

自本次发行董事会决议日前六个月至本回复签署日，公司未新增对外股权投资，亦无新增对外股权投资的计划。

(4) 投资产业基金、并购基金

自本次发行董事会决议日前六个月至本回复签署日，公司不存在投资产业基金、并购基金的情形，亦无拟投资产业基金、并购基金的计划。

(5) 拆借资金

自本次发行董事会决议日前六个月至本回复签署日，公司不存在对外资金拆借情形，亦无拟实施资金拆借的计划。

(6) 委托贷款

自本次发行董事会决议日前六个月至本回复签署日，公司不存在将资金以委托贷款的形式借予他人的情况，亦无拟实施委托贷款的计划。

(7) 以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资

自本次发行董事会决议日前六个月至本回复签署日，公司不存在集团财务公司，不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形，亦无以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的计划。

(8) 购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行董事会决议日前六个月至本回复签署日，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形，亦无拟购买收益波动大且风险较高的金融产品的计划。

(五) 核查程序及核查结论

1. 核查程序

针对上述事项，我们主要执行了以下核查程序：

(1) 获取公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月的财务报表、收入成本明细表和产能利用率明细表，对公司的业绩变动情况进行分析；询问公司管理层，了解公司业绩变动原因；

(2) 获取同行业公司的财务报表和年度报告，将公司的业绩变动情况与同行业可比公司进行对比分析；

(3) 查阅相关行业研究报告，了解行业的竞争格局和发展趋势；

(4) 获取公司报告期各期末应收账款明细表、账龄明细表、坏账准备计提表、期后回款统计表、坏账准备计提政策，核查坏账准备计提的充分性；查阅同行业

可比公司坏账准备计提政策，分析公司坏账准备计提是否审慎、合理；

(5) 获取公司报告期各期末在建工程明细表，并抽查在建工程转固凭证、《设备验收单》《竣工验收单》等资料，核查在建工程转固时点的准确性；获取公司报告期内产能利用率统计表，了解公司新增产能的消化情况；

(6) 获取公司最近一期末交易性金融资产、其他应收款、其他非流动金融资产、其他非流动资产等科目明细，查阅投资协议等资料，了解被投资企业的业务性质和投资背景，判断公司是否存在财务性投资情况，以及本次发行董事会决议日前六个月内是否存在新投入和拟投入的财务性投资。

2. 核查结论

经核查，我们认为：

(1) 报告期内，公司晶圆测试单价呈波动上升趋势，芯片成品测试单价呈先下降后回升趋势，测试总工时逐年稳定上升且产能利用率均维持在较高水平，上述因素共同驱动公司业绩高速增长；

(2) 2024 年度利扬芯片、华岭股份受行业周期下行影响，营业收入有所下降，公司及朗迅科技仍保持增长；2025 年以来公司与同行业可比公司营业收入均呈增长趋势，业绩变动方向一致，增速差异主要系各公司产品结构、客户结构及收入基数不同所致，与各自测试单价、测试工时及产能利用率的变化相匹配，具有合理性，公司与同行业可比公司不存在重大差异；

(3) 报告期内，公司综合毛利率分别为 38.96%、37.11%、39.37%和 33.59%，其中 2026 年 1-6 月综合毛利率下降较为明显，主要系行业季节性因素及新增产能爬坡影响所致；

(4) 报告期各期末，公司应收账款增长主要系产能扩张所致，具备合理性；公司报告期各期末应收账款坏账准备计提充分，与同行业可比公司相比不存在重大差异；

(5) 报告期内，公司主要在建工程的转固时点为达到预定可使用状态，不存在应转固未及时转固的情形；公司报告期内新增产能得到有效消化，新增固定资产主要为高端测试设备，不存在闲置及减值的风险；

(6) 截至最近一期末，公司未持有金额较大的财务性投资；本次发行董事会决议日前六个月至本回复签署日，公司不存在新投入和拟投入的财务性投资。

专此说明，请予察核。



中国注册会计师：周新



中国注册会计师：张建



二〇二六年九月十六日